

合肥晶合集成电路股份有限公司

2024 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日。

（二）业绩预告情况

经合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）业务及财务部门初步核算和预测，预计 2024 年前三季度实现营业收入 670,000.00 万元到 680,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 168,311.92 万元到 178,311.92 万元，同比增长 33.55%到 35.54%。

预计 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 27,000.00 万元到 30,000.00 万元，与上年同期相比，将增加 23,800.99 万元到 26,800.99 万元，同比增长 744.01%到 837.79%。

二、上年同期业绩情况

2023 年前三季度（未经审计），公司实现营业收入 501,688.08 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,199.01 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、随着行业景气度逐渐回升，公司自今年 3 月起产能持续处于满载状态，并于今年 6 月起对部分产品代工价格进行调整，助益公司营业收入和产品毛利水平稳步提升。

2、2024 年随着 CIS 国产化替代加速，公司紧跟行业内外业态发展趋势，持续调整、优化产品结构。CIS 产能处于满载状态，后续公司将根据客户需求重点

扩充 CIS 产能。

3、公司高度重视研发体系建设，持续增加研发投入。目前 55nm 中高阶单芯片及堆栈式 CIS 芯片工艺平台已大批量生产，40nm 高压 OLED 芯片工艺平台已实现小批量生产，28nm 逻辑芯片通过功能性验证，28nm OLED 驱动芯片预计将于 2025 年上半年批量量产。公司将加强与战略客户的合作，加快推进 OLED 产品的量产和 CIS 等高阶产品开发。

四、风险提示

本次业绩预告为前瞻性陈述，是公司业务及财务部门基于自身专业判断进行的初步核算和预测，尚未经注册会计师审计。截至本公告披露日，公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日